



| | | |
|---|-----------------|---------------------------|
| UNIVERSITAS TELKOM | No. Dokumen | ITT-AK-FEK-PTT-FM-004/001 |
| Jl. Telekomunikasi No. 1 Ters. Buah Batu Bandung 40257 | No. Revisi | 00 |
| FORMULIR LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR | Berlaku efektif | 02 Mei 2011 |

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PENGARUH PENYISIPAN TEMBAGA Cu MENGGUNAKAN METODE *PULSE* *PLATING* PADA SEL SURYA TiO₂

*(EFFECT OF COPPER INSERTION USING PULSE PLATING METHOD ON
TiO₂ SOLAR CELLS)*

Telah disetujui dan disahkan sebagai Tugas Akhir
Program S1 Teknik Fisika
Fakultas Teknik Elektro
Universitas Telkom

Disusun Oleh:
Ramadan Pratama Gumilar
1108100006

Bandung, Oktober 2014
Menyetujui

Pembimbing I,

Mamat Rokhmat, S.Si., M.Si

NIP: 00760200-1

Pembimbing II,

Edy Wibowo, S.Si., MSc.

NIP : 14861290-1